

中国在全球半导体产业链占多大比例？

美国及其盟友是全球半导体供应链的领导者，而中国大陆相对落后。美国半导体产业贡献了全球半导体供应链总价值的39%。美国的盟国和地区——日本、欧洲(特别是荷兰、英国和德国)、中国台湾和韩国——总共贡献了53%。这些国家和地区在几乎每个供应链环节上都享有竞争优势。虽然中国大陆的贡献仅为6%，但它正在许多领域迅速发展能力，并可能试图重新配置有利于自己的供应链，从而影响国家和国际安全。

在高层次上，半导体供应链包括研发、生产、生产投入和最终使用的分销。研发支撑着所有的生产及其投入。半导体生产包括三个部分：(1)设计；(2)制造；(3)封测(ATP)。生产依赖于供应链的相关元素：半导体制造设备(SME)、材料(包括形成芯片的“晶片”)、设计软件(称为电子设计自动化，或EDA，软件)和与芯片设计相关的知识产权(称为核心IP)。这一过程中价值最高、技术最复杂的部分是生产的设计和制造环节，以及供应链中的SME部分。虽然是在供应链中占据很小，但EDA和核心IP也很关键，这需要大量的专业知识。而ATP是一种劳动密集型行业，进入门槛最低。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/6333.html>